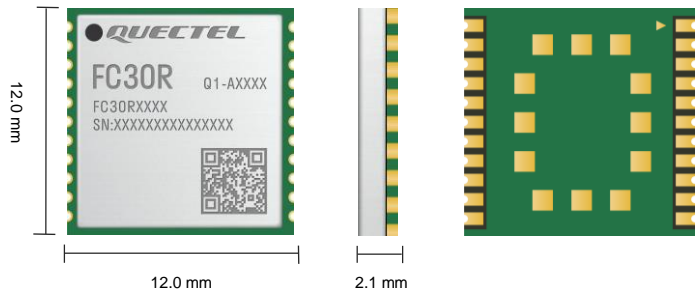


# Quectel FC30R

## Wi-Fi 模块 超紧凑型LCC封装



FC30R是移远通信推出的尺寸小、高性价比的工规级Wi-Fi模块。其超紧凑的封装尺寸12.0 mm × 12.0 mm × 2.1 mm，能最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品的需求，并帮助客户有效减小产品尺寸、降低产品成本。

FC30R采用SMT贴片技术，可靠性高并能满足复杂环境的应用需求。紧凑的LCC封装使其尤其适用于尺寸受限且要求可靠性网络连接的场合。模型采用镭雕工艺，散热性更好、信息不容易被抹除。先进的封装和激光镭雕工艺可实现对成本和效率有严格要求的大规模自动化生产。

结合其紧凑尺寸、低功耗、超宽的温度范围和稳定的SDIO接口等优点，FC30R通常与移远通信LTE Standard EC21系列、EC25系列、EC20-CE和EG25-G模块以及其他应用处理器结合使用（IMX6、IMX8等），服务于各种M2M应用，例如智能安全、工业级PDA、MiFi和医疗等。



### 主要优势

- ✓ 尺寸紧凑且超高性价比的Wi-Fi模块
- ✓ 支持IEEE 802.11 b/g/n标准
- ✓ 采用LCC封装，简化焊接与测试过程
- ✓ 支持SDIO接口，确保通信稳定可靠
- ✓ 产品设计简单，满足客户产品快速上市需求



超紧凑尺寸



LCC 封装



IEEE 802.11 b/g/n 标准



SDIO 接口



工作温度范围：  
-40 °C ~ +85 °C

Wi-Fi	FC30R	
地区	全球	
功能	2.4 GHz Wi-Fi	
WLAN协议	IEEE 802.11 b/g/n	
调制方式	DBPSK、DQPSK、BPSK、QPSK、CCK、16QAM、64QAM	
温度范围		
工作温度	-40 °C ~ +85 °C	
最大数据传输速率		
802.11b	11 Mbps	
802.11g	54 Mbps	
802.11n	150 Mbps	
接口		
SDIO	× 1	
天线	× 1	
电气特性		
电源供电电压	3.0~3.6 V，典型值3.3 V	
I/O口供电电压	<ul style="list-style-type: none"><li>1.75~1.89 V，典型值1.8 V</li><li>3.0~3.6 V，典型值3.3 V</li></ul>	
耗流（典型值）	关机状态： 31 μA @ VDD_3V3电源供电 1 μA @ VDD_SDIO电源供电 空闲（无连接）： 60 mA @ VDD_3V3电源供电 2 mA @ VDD_SDIO电源供电	
一般特性		
加密方式	WPA3	
无线访问接入点（最多）	16	
工作模式	AP/STA	
尺寸	12.0 mm × 12.0 mm × 2.1 mm	
重量	约 0.58 g	
认证		
强制认证	中国：SRRC 欧洲：CE 美国：FCC 加拿大：IC 韩国：KC* 日本：JATE/TELEC 澳大利亚/新西兰：RCM	
射频特性		
	接收灵敏度（典型值）	发射功率（范围）
802.11b/1 Mbps	-93 dBm	16 ±2.5 dBm
802.11b/11 Mbps	-86 dBm	16 ±2.5 dBm
802.11g/6 Mbps	-87 dBm	16 ±2.5 dBm
802.11g/54 Mbps	-70 dBm	14 ±2.5 dBm
802.11n (HT20)/MCS 0	-87 dBm	15 ±2.5 dBm
802.11n (HT40)/MCS 0	-84 dBm	15 ±2.5 dBm
802.11n (HT20)/MCS 7	-68 dBm	13 ±2.5 dBm
802.11n (HT40)/MCS 7	-64 dBm	13 ±2.5 dBm

备注：  
\*：表示规划中。